

※課題番号 : F-12-WS-0017
※支援課題名 (日本語) : 基板接合技術の開発
※Program Title (in English) : Development of Wafer Bonding Technology
※利用者名 (日本語) : 青田 奈津子
※Username (in English) : Natsuko Aota
※所属名 (日本語) : 並木精密宝石株式会社
※Affiliation (in English) : Namiki Precision Jewel Co., Ltd.

※概要 (Summary) :

接合装置 SB6e (SUSS Microtech 社製) を用いて 2 インチ φ Si 基板とサファイア基板の接合実験を実施した結果、シリコン基板とサファイア基板は接合できることを確認した。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし。

関連特許 (Patent) :

なし。

※実験 (Experimental) :

接合装置 SB6e (SUSS Microtech 社製) を用いて 2 インチ φ Si 基板とサファイア基板の接合実験を実施した。

※結果と考察 (Results and Discussion) :

図 1 に示すようにシリコン基板とサファイア基板は接合できることを確認した。以下に接合後の基板の写真を示す。

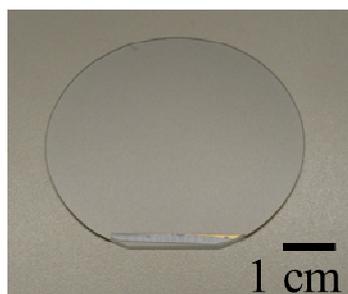


図 1 2 インチ基板接合後 光学写真

今後、接合条件の最適化を図り、接合強度等について評価を行っていく予定である。

※その他・特記事項 (Others) :

なし。

共同研究者等 (Coauthor) :

なし。